

# Kupferbad SLOTOCOUP SF 30

Das Kupferbad SLOTOCOUP SF 30 wird bei der Produktion von HDI-Leiterplatten eingesetzt, um Blind Microvias vollständig zu füllen, hierbei aber nur eine sehr dünne Kupferschicht auf der Leiterplattenoberfläche abzuscheiden. Des Weiteren wurde es speziell für den mSAP Prozess (modified Semi Additive Prozess) weiterentwickelt.

Die aus dem Kupferbad SLOTOCOUP SF 30 abgeschiedenen Schichten sind hochglänzend und weisen eine hervorragende Einebnung auf. Dieser Elektrolyt wurde speziell für den Einsatz in vertikalen Durchlaufanlagen entwickelt.

Der Ansatz von Kupferbad SLOTOCOUP SF 30 erfolgt mit drei Flüssigzusätzen.

Die Angaben in der Gebrauchsanweisung basieren auf unseren Labor- und Praxiserfahrungen. Da Ergänzungsmengen und Eingriffsgrenzen in Abhängigkeit von Materialart und -geometrie, deren Anwendung und der Anlagentechnik ggf. von den Angaben in der Gebrauchsanweisung abweichen können, sind diese Angaben nicht bindend.

## Wichtiger Hinweis!

Wir bitten, diese Gebrauchsanweisung vor Einsatz des Verfahrens sorgfältig zu lesen und alle die Arbeitsweise beeinflussenden Parameter zu beachten. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Im Interesse der eigenen Sicherheit beachten Sie bitte unbedingt die Gefahrenhinweise auf den Etiketten der Gebinde. Die Mindesthaltbarkeit der Produkte kann ebenfalls den Gebindeetiketten oder dem entsprechenden Qualitätszertifikat (QA03) entnommen werden.

Die aktuelle IMDS-Nummer für die aus dem Verfahren abgeschiedene Schicht kann im Internet unter [www.schloetter.de/downloads](http://www.schloetter.de/downloads) eingesehen werden.

Für die Lagerung von chemischen Produkten ist die TRGS 510 maßgebend.

**Falls in den verwendeten Zusätzen dieses Verfahrens SVHC-Stoffe enthalten sind, so werden diese in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern im Abschnitt 15 ausgewiesen.**

